

经营业绩再上新台阶，半导体封测设备成为重要增长极 —— 半导体设备系列报告

事件

事件一

公司 2021 年实现营业收入 5.30 亿元，同比+70.33%，归母净利润 1.18 亿元，同比+98.78%，扣非归母净利润 0.67 亿元，同比+31.89%；其中 Q4 单季度营业收入 1.78 亿元，同比+33.58%，归母净利润 0.38 亿元，同比+118.72%，扣非归母净利润 0.17 亿元，同比+1.45%。

事件二

公司 2022 年一季度预计归母净利润 0.20-0.24 亿元（中位数 0.22 亿元），同比+150%-200%（中位数同比+175%）。

简评

传统业务稳步增长，并表 ADT 带动半导体业务业绩高增

①受益于半导体封装设备放量，公司业绩实现高速增长。2021 年公司实现营业收入 5.30 亿元，同比增长 70.33%。公司业绩增长主要原因为半导体封装设备放量，其收入增长 1.99 亿元，贡献公司收入增长的 91.01%，为公司收入增长主要驱动力。

②扣非后归母净利润增速慢于收入，业务结构变化带来毛利率波动。公司全年实现净利润 1.18 亿元，同比增长 98.78%；扣非后归母净利润 0.67 亿元，同比增长 31.89%。公司扣非后归母净利润增速弱于收入主要系：毛利率稍低的半导体封装设备收入占比快速提升，使公司整体毛利率下降 9.23pct 至 53.41%。此外，公司销售费用率提升也部分影响公司净利润表现。

③一季度业绩增长迅猛，半导体封测设备持续发力。预计公司 2022Q1 实现归母净利润为 0.20-0.24 亿元，同比增长 150%-200%。公司业绩实现高速增长主要原因包括：一是公司半导体划片机 8230 自 2021Q4 以来延续高增长，同时以色列 ADT 海外布局趋于完善；②ADT 并表贡献 500 万归母净利润；③传统主业受益于国家新《防治煤与瓦斯突出细则》出台，下游需求持续向好，实现较好销售。一季度业绩优异表现为公司全年业绩奠定良好基础。

光力科技 (300480)

首次评级

买入

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 执证编号：S1440519080001

SFC 中央编号：BOU764

发布日期：2022 年 04 月 01 日

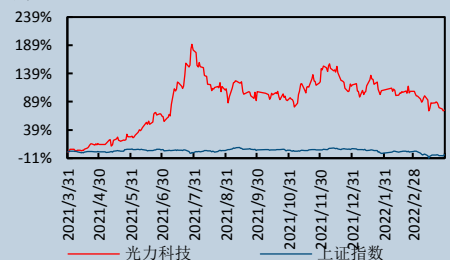
当前股价：27.28 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
-16.27/-10.91	-19.62/-9.88	71.79/77.29
12 月最高/最低价 (元)		46.88/15.5
总股本 (万股)		26,963.9
流通 A 股 (万股)		15,912.41
总市值 (亿元)		73.56
流通市值 (亿元)		43.41
近 3 月日均成交量 (万股)		253.85
主要股东		
赵彤宇		35.7%

股价表现



相关研究报告

物联网安全生产监控装备：业绩稳中有进，煤矿智能化带来新增长机遇

①**业绩稳步提升，仍为公司第一大收入来源。**2021 年公司安全生产及节能监控业务实现收入 2.92 亿元，同比增长 7.15%，收入占比 55.14%。公司安全生产及节能监控业务产品包括矿山安全生产监控类、电力安全节能环保类及专用配套设备三大类产品，下游包括煤矿、电力安全、节能环保等领域。得益于下游煤矿行业智能化改造以及公司行业优势竞争地位，该板块实现稳步增长。

②**展望未来，行业智能化改造带来安全生产监控装备长期向上需求。**2020 年国家发展改革委、财政部等部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，意见要求加大煤矿智能化改造，到 2025 年基本实现大型煤矿、灾害严重煤矿基本实现智能化。智能化趋势下必然对公司设备提供更多需求，带动其长期向上增长。

半导体封测设备：历经三次海外并购，完善半导体精密切割设备及核心零部件等布局

①**收入高速增长，收入占比显著提升。**半导体封测装备全年实现收入 2.38 亿元，同比增长 518.74%，收入占比达 44.86%。2021 年公司半导体封测设备业绩高增主要原因包括：**首先**，行业高景气+半导体设备国产趋势驱动。芯片短缺背景下，国内外晶圆厂、封测厂均加大扩产力度，2021 年全球半导体设备市场空间较上年增长 45%至 1030 亿美元历史新高，封测设备市场需求进入井喷状态。国产替代趋势进一步加速国产设备市占率提升；**其次**，ADT 并表增厚公司业绩。公司进一步收购完成先进微电子 79.95% 股权，进而间接持有 ADT 94.90% 股权。ADT 自 2021 年 5 月份纳入合并报表，增厚公司业绩；**最后**，公司切割划片机导入头部客户形成销售，进入放量阶段。

②**三次海外并购使得公司具备半导体封测设备及核心部件研制能力。**公司当前半导体封测设备业务具体包括晶圆切割划片机、全自动 UV 解胶机、自动切割贴膜机、半自动晶圆清洗机等设备以及刀片等耗材。该业务由公司先后并购 LP、LPB、ADT 而来。其中 LP 为全球首家开发半导体切割划片机的企业，LPB 则掌握高性能高精精密空气主轴，ADT 则为全球第三大切割划片设备公司。三者均深耕行业多年，具有较强技术、客户等资源。得益于此，公司也成为全球仅有的两家可同时提供切割划片设备、核心零部件企业之一，形成较强协同效应。

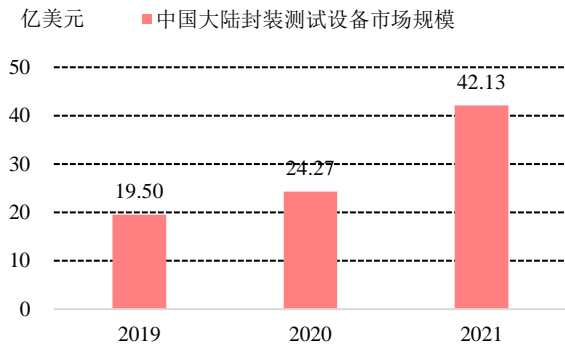
图表1： 公司历经三次海外并购整合优质资产

标的	所属地区	公司持股比例	主营业务	收购进度
Loadpoint Limited	英国	100%	划片机	2016 年收购其 70% 股权，2020 年收购剩余 30%
Loadpoint Bearings Limited	英国	100%	高性能高精精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器	2017 年收购其 70% 股权，2020 年收购剩余 30%
Advanced Dicing Technologies Ltd	以色列	94.9%	划片机设备和耗材（包括刀片等）	2019 年参股子公司先进微电子收购其 100% 股权，2021 年公司持先进微电子的股权增加至 94.90%，进而间接持有其 94.90% 股权

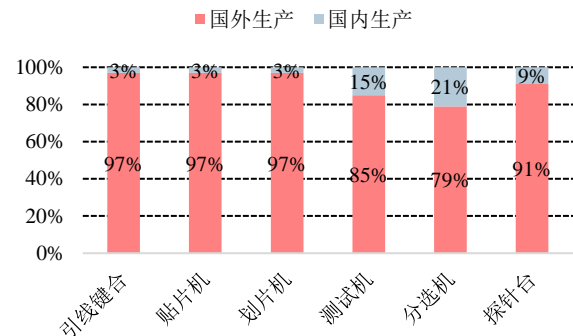
资料来源：公司公告，中信建投

③**封装设备空间广阔，国产化率存在较大提升空间。**封测设备为半导体设备重要组成部分，2021 年全球封测设备市场空间约 150 亿美金，其中中国地区市场约为 42 亿美金。进一步拆分看，封装设备约占其中 45-50%。若以划片机在封装设备价值量 15% 计算，对应国内市场空间超 20 亿元，且随行业扩张保持较快增长。与之形成反

差的是，当前包括切割划片在内的封装设备国产化率普遍偏低，公司作为国内头部的切割划片设备供应商将充分受益后续行业国产化进程。

图表2： 中国大陆地区封装设备市场快速增长


资料来源: SEMI, 中信建投

图表3： 国内划片机国产化率仍有极大提升空间


资料来源: Gartner, 中信建投

投资建议：分业务看，传统物联网安全生产设备方面，随着国内煤矿智能化等行业政策的逐步推进，将继续保持稳步增长态势；半导体封测设备方面，公司整合海外优质资产，受益于半导体设备行业高景气+国产替代浪潮，有望延续高增长，成为公司收入增长重要驱动力。预计公司 2022-2024 年实现归母净利润分别为 1.81、2.36、3.03 亿元，同比分别增长 53.0%、31.0%、28.3%，对应 PE 分别为 39.5x、30.1x、23.5x，维持“买入”评级。

风险因素：

- ①**行业景气度下行风险：**封测行业景气度存在周期性波动，若行业景气度下滑则会对公司产品需求产生不利影响。
- ②**行业竞争加剧带来毛利率下降风险：**若行业竞争进一步加剧，则有可能带来毛利率进一步下行。
- ③**疫情反复带来供应链紧张风险：**国内疫情反复可能会对公司供应链产生扰动，影响其正常的生产经营。

重要财务指标

	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	311	530	846	1,191	1,564
增长率(%)	4.9	70.3	59.5	40.9	31.2
净利润(百万元)	59	118	181	236	303
增长率(%)	5.8	98.8	53.0	31.0	28.3
ROE(%)	7.7	8.9	12.0	13.8	15.2
EPS(元/股, 摊薄)	0.24	0.44	0.51	0.67	0.87
P/E(倍)	114.3	62.2	39.5	30.1	23.5
P/B(倍)	8.8	5.5	6.4	5.6	4.8

资料来源: Wind, 中信建投

分析师介绍

吕娟：董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明: (i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
 电话:(8610) 8513-0588
 联系人:李祉瑶
 邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
 电话:(8621) 6882-1600
 联系人:翁起帆
 邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
 电话:(86755) 8252-1369
 联系人:曹莹
 邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
 中环交易广场2期18楼
 电话:(852) 3465-5600
 联系人:刘泓麟
 邮箱:charleneliu@csci.hk